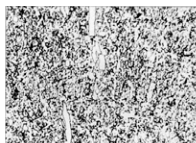
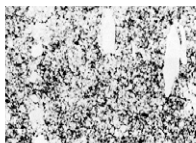


■微細・均一なマイクロ組織



DC53



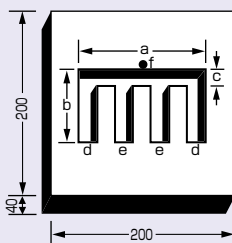
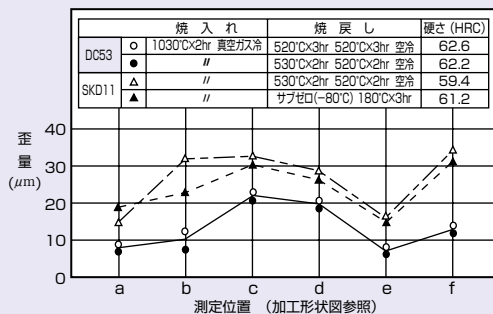
SKD11

■目的・用途に応じた熱処理サイクルの選定

用途・目的	焼入れ(℃)	焼戻し	目標硬さ(HRC)
一般の用途 (SKD11と同一の熱処理サイクル)		180~200 500~550	60~62 60~63
強度重視 (摩耗・ヘタリ・かじり・疲労強度対策)		520~550	62~63
靱性重視 (割れ・折損・チッピング)		200~350	59~62
熱処理変寸対策	1020~1040	350~510	59~62
放電加工・ワイヤ放電加工 トラブル対策		500~550	60~63
経年変化対策		500~550 +400	60~63
PVD処理の前熱処理		520~550	62~63

■ワイヤ放電加工精度

熱処理条件とワイヤ放電加工後の歪量との関係



(加工形状・寸法)

a=140.0mm

b=62.5

c=20.0

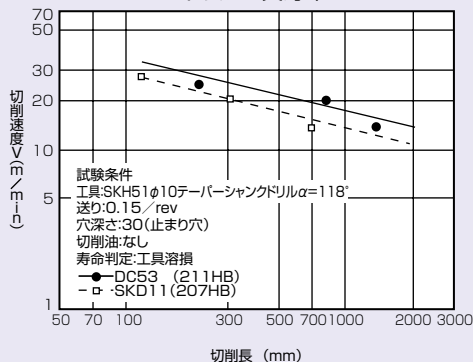
d=20.0

e=17.0

f=スタート穴=0

■被切削性と被研削性

ドリル工具寿命



研削性比較(円筒研削)

